



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
06.08.2008 Patentblatt 2008/32

(51) Int Cl.:
E04F 15/02^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **07101506.9**

(22) Anmeldetag: **31.01.2007**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR MK RS

(71) Anmelder: **Sika Technology AG**
6340 Baar (CH)

(72) Erfinder: **Die Erfindernennung liegt noch nicht vor**

(74) Vertreter: **Sika Patent Attorneys**
c/o Sika Technology AG
Corp. IP Dept.
Tüffenwies 16
Postfach
8048 Zürich (CH)

(54) **Verfahren zum Anbringen eines Bodenbelages auf einen Boden**

(57) Bei einem Verfahren zum Anbringen eines Bodenbelages (6) auf einen Boden (1), werden Schlitzte (4) in den alten Bodenbelag (2) eingebracht, Klebstoff (5)

wird in die Schlitzte (4) eingebracht, der neue Bodenbelag (6) aufgebracht und der neue Bodenbelage (6) mit dem Boden (1) verklebt.

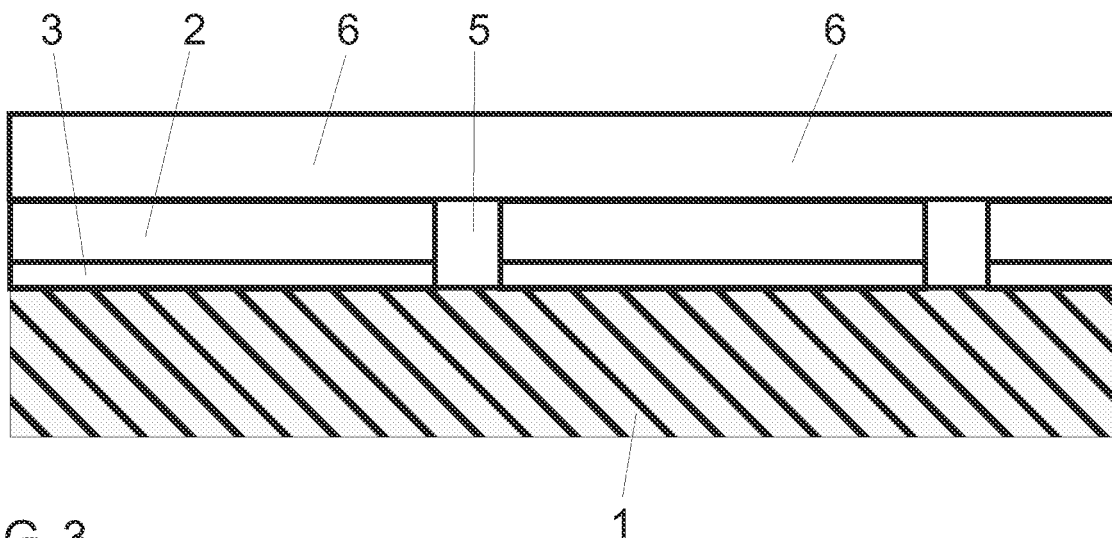


FIG. 3

1

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren nach dem Oberbegriff des ersten Anspruchs.

Stand der Technik

[0002] Wenn alte Bodenbeläge durch neue ersetzt werden sollen, werden bisher die alten Bodenbeläge herausgerissen und der Boden angeschliffen, um Klebstoffreste zu entfernen. Danach muss der Boden gereinigt werden, damit eine neue Klebschicht auf dem Boden haften kann. Nachdem der neue Klebstoff aufgebracht wurde, wird der neue Bodenbelag auf den Boden aufgebracht. Dies ist ein sehr aufwändiger und arbeitsintensiver Prozess.

Darstellung der Erfindung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Verfahren der eingangs genannten Art die Aufbringung eines neuen Bodenbelages zu vereinfachen.

[0004] Erfindungsgemäss wird dies durch die Merkmale des ersten Anspruchs erreicht.

[0005] Kern der Erfindung ist es also, dass Schlitze in den alten Bodenbelag eingebracht werden, dass Klebstoff in die Schlitze eingebracht wird, dass der neue Bodenbelag aufgebracht wird und dass der neue Bodenbelag mit dem Boden verklebt wird.

[0006] Die Vorteile der Erfindung sind unter anderem darin zu sehen, dass ein einfaches und kostengünstiges Verfahren zur Verfügung gestellt wird. So muss beim erfindungsgemässen Verfahren der alte Bodenbelag nicht entfernt und entsorgt werden, es muss nicht gereinigt und allenfalls vorbehandelt / geprimert werden, wodurch Arbeitsschritte entfallen. Der neue Bodenbelag kann auch problemlos auf dreckigen Bodenbelägen aufgebracht werden. Insbesondere wenn der alte Bodenbelag weich ist, kann auf die Verwendung zusätzlicher Trittschalldämpfender Matten verzichtet werden.

[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0008] Im folgenden werden anhand der Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert. Gleiche Elemente sind in den verschiedenen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0009] Es zeigen:

- Fig. 1 einen Teilquerschnitt durch einen Boden mit erfindungsgemässen Schlitzen;
 Fig. 2 einen Teilquerschnitt durch einen Boden mit erfindungsgemässen Schlitzen und darin angeordnetem Klebstoff;

- Fig. 3 einen Teilquerschnitt durch einen Boden mit erfindungsgemäss angebrachtem Bodenbelag;
 Fig. 4 einen Teilquerschnitt durch einen Boden mit erfindungsgemäss angebrachtem Bodenbelag und zusätzlicher Matte;

[0010] Es sind nur die für das unmittelbare Verständnis der Erfindung wesentlichen Elemente gezeigt.

Weg zur Ausführung der Erfindung

[0011] In Fig. 1 ist ein Boden 1, insbesondere ein Betonboden, welcher mit einem Bodenbelag 2 versehen ist, dargestellt. Der Bodenbelag kann ein Teppich, ein Kunststoffbelag, wie beispielsweise ein PVC-Belag, ein Plattenbelag, ein Parkettbelag, ein gegossener Kunststoffbelag, usw. sein. Der Bodenbelag 2 ist mit dem Boden 1 verbunden, beispielsweise mit einer Klebschicht 3. Diese Klebschicht kann an sich beliebig ausgeführt sein und hält den Bodenbelag am Boden fest. Die Klebschicht kann ein Kunststoffkleber sein, jedoch auch ein Mörtel, z.B. bei einem Plattenbelag, es kann jedoch auch auf die Klebschicht verzichtet werden, wenn z.B. ein gegossener Kunststoffbelag verwendet wird, welcher selber haftet. Allenfalls kann auch ein Primer zur Anwendung kommen.

In den Bodenbelag 2, und allenfalls in die Klebschicht 3, werden nun Schlitze 4 eingebracht. Dies kann von Hand mit einem Messer, mit einer Maschine mit speziellen Messern, mit einer Fräse, usw. erfolgen. Die Schlitze werden vorteilhafterweise so angebracht, dass der Boden 1 freiliegt, insbesondere kann die Oberfläche des Bodens leicht abgetragen werden. Solche Schlitze werden beispielsweise in einem Abstand von 5 bis 10 cm angebracht und sind 1 bis 2 cm breit.

[0012] Entsprechend Fig. 2 wird nun Klebstoff 5 in die Schlitze 4 eingebracht, so dass der Klebstoff 5 zumindest leicht über die Oberfläche des Bodenbelages hervorsteht. Die Klebstoffraupe kann dabei verschiedenen Formen aufweisen, wie eine Dreiecksform, usw., und kann dem gewünschten Verklebungsergebnis angepasst werden.

[0013] Danach wird der neue Bodenbelag 6 entsprechend Fig. 3 auf die Oberfläche des alten Bodenbelages 2 und den Klebstoff 5 aufgelegt und mittels des Klebstoffes 5 mit dem Boden 1 verbunden. Der neue Bodenbelag 6 kann ein Teppich, ein Kunststoffbelag wie beispielsweise ein PVC-Belag, ein Parkettbelag, usw. sein. Somit werden bei der Verlegung des neuen Bodenbelages keine zusätzlichen Matten, beispielsweise zur Trittschalldämpfung benötigt.

Als Klebstoff kann eine beliebiger Klebstoff verwendet werden, welcher jeweils dem Boden 1 sowie dem neuen Bodenbelag 6 angepasst wird. Ein besonders vorteilhafter Klebstoff ist SikaBond®-T52, SikaBond®-T52 FC, SikaBond®-T53, SikaBond® AT-84.

[0014] Nach Fig. 4 kann natürlich auch zusätzlich eine Matte 7 mit Schlitzen auf den alten Bodenbelag 2 aufge-

legt werden. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn der alte Bodenbelag eine harte Struktur aufweist, z.B. bei einem Platten- oder Parkettbelag. Die Schlitzze 4 liegen dann übereinander, wobei die Matte vorteilhafterweise aufgelegt wird, bevor der Klebstoff in die Schlitzze eingebracht wird. 5

[0015] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf das gezeigte und beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. Das vorliegende Verfahren kann auf allen Arten von Böden, alten Bodenbelägen und neuen Bodenbelägen verwendet werden. 10

Bezugszeichenliste

15

[0016]

- | | | |
|---|------------------|----|
| 1 | Boden | |
| 2 | alter Bodenbelag | |
| 3 | Klebschicht | 20 |
| 4 | Schlitz | |
| 5 | Klebstoff | |
| 6 | neuer Bodenbelag | |
| 7 | Matte | 25 |

Patentansprüche

1. Verfahren zum Anbringen eines Bodenbelages (6) auf einen Boden (1), umfassend, 30
 dass Einbringen von Schlitzzen (4) in den alten Bodenbelag (2),
 dass Einbringen von Klebstoff (5) in die Schlitzze (4),
 dass Aufbringen des neuen Bodenbelages (6) und das Verkleben des neuen Bodenbelages (6) mit dem Boden (1). 35
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**
dass die Schlitzze (4) bis auf den Boden (1) angebracht sind. 40
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet,**
dass zwischen altem Bodenbelag (2) und neuem Bodenbelag (6) eine Matte (7) angeordnet ist. 45
4. Bodenbelag hergestellt nach dem Verfahren entsprechend einem der vorhergehenden Ansprüche. 50

55

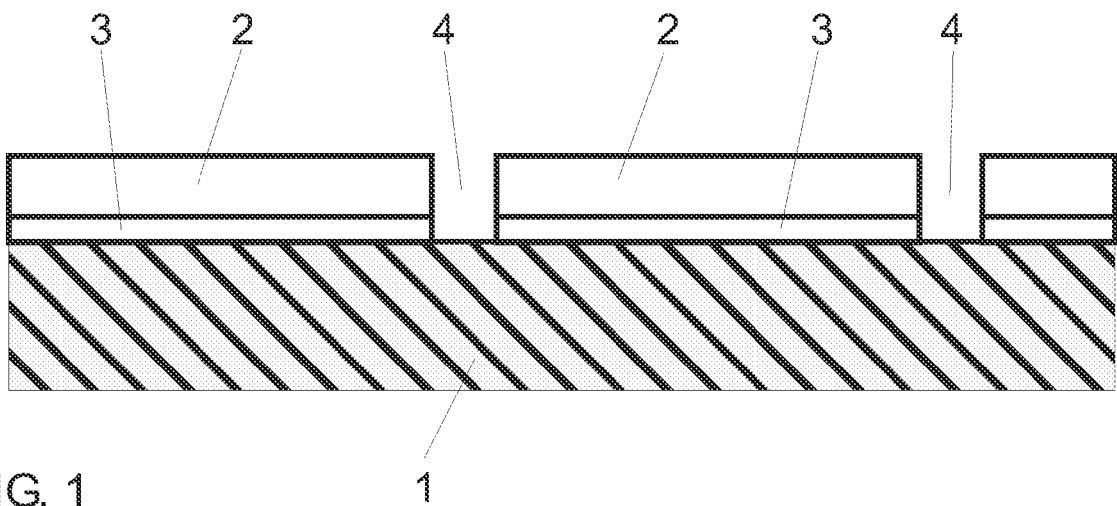


FIG. 1

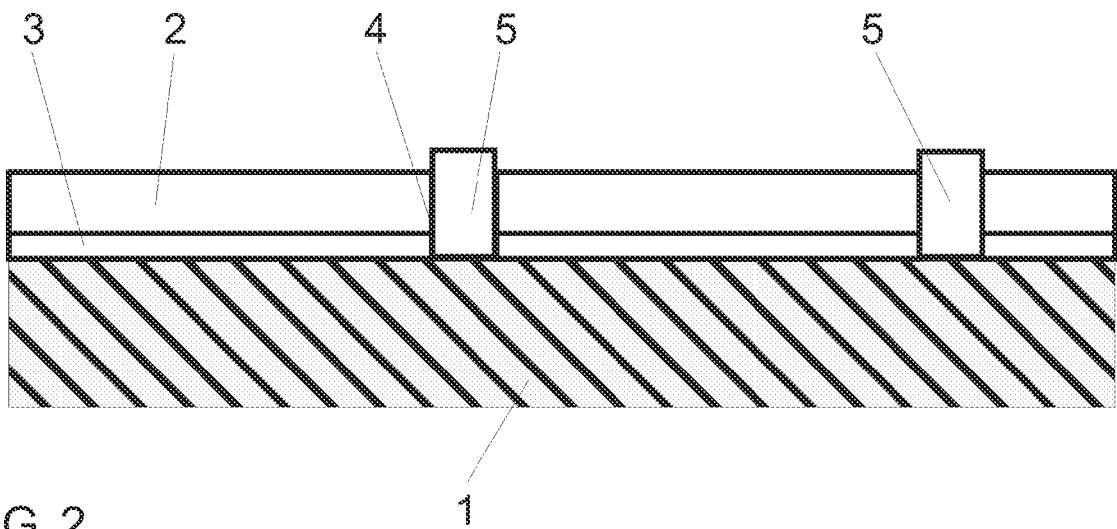


FIG. 2

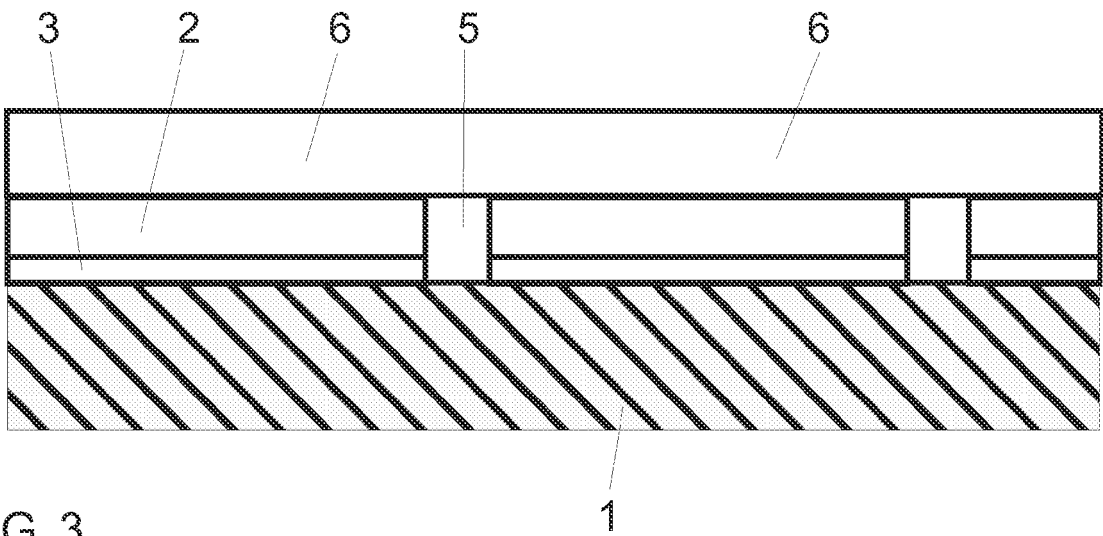


FIG. 3

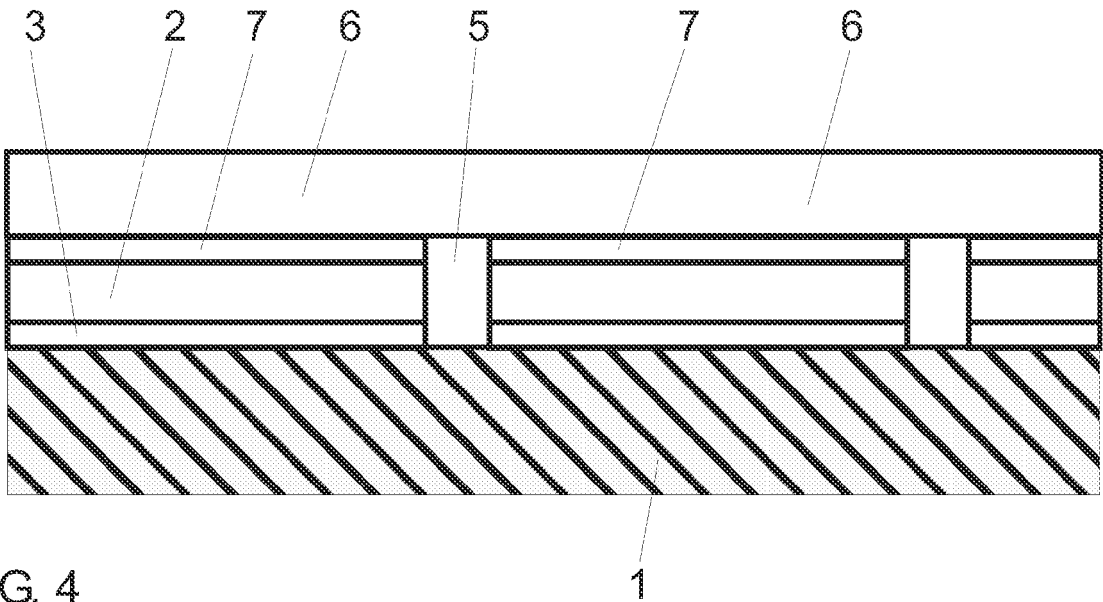


FIG. 4



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 07 10 1506

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	DE 102 53 553 A1 (KATTWINKEL FRIEDER [DE]) 2. Oktober 2003 (2003-10-02) * Abbildungen 8-10 *	4	INV. E04F15/02
X	WO 99/49152 A (CASA DA VINCI BODENSYSTEME GMB [DE]; KORZILIUS MARK [DE]) 30. September 1999 (1999-09-30) * Abbildung 3 *	4	
A	EP 0 182 567 A (PLASMOR INSULATION LTD [GB]) 28. Mai 1986 (1986-05-28) * Abbildung 9 *	1,4	
A	DE 197 55 626 A1 (ESSER RUDOLF [DE]) 17. Juni 1999 (1999-06-17)	1	
X	* Abbildungen 2,3 *	4	
A	WO 02/40806 A (LU ERIC CHIA CHUN [US]; LU CHIA LUNG [CN] LU CHIA-LUNG [CN]; LU ERIC C) 23. Mai 2002 (2002-05-23)	1	
A	WO 02/088486 A (ABRAHAMS JACOB [BR]; BURKHARDT HEIDY [DE]) 7. November 2002 (2002-11-07) * Abbildungen 1-3 *	1,4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) E04F
A	DE 92 13 604 U1 (GRUND, WILFRIED, 8050 FREISING, DE) 25. März 1993 (1993-03-25) * Abbildung 5 *	1	
A	US 2002/071931 A1 (DRAKE ROBERT H [US]) 13. Juni 2002 (2002-06-13) * Abbildung 1 *	1	
A	NL 1 028 415 C2 (BOLIDT MIJ TOT EXPLOITATIE VAN [NL]) 3. April 2006 (2006-04-03) * Abbildungen 1-5 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 19. Juni 2007	Prüfer Severens, Gert
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

2
EPO FORM 1503 03/02 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 07 10 1506

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

19-06-2007

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 10253553	A1	02-10-2003	KEINE		

WO 9949152	A	30-09-1999	AU	3925899 A	18-10-1999
			EP	1066434 A1	10-01-2001

EP 0182567	A	28-05-1986	KEINE		

DE 19755626	A1	17-06-1999	KEINE		

WO 0240806	A	23-05-2002	AU	1754401 A	27-05-2002
			BR	0017373 A	09-12-2003
			CA	2428367 A1	23-05-2002
			CN	1479826 A	03-03-2004
			EP	1337711 A2	27-08-2003
			JP	2004514077 T	13-05-2004
			MX	PA03004260 A	22-09-2003

WO 02088486	A	07-11-2002	BR	0102141 A	31-12-2002

DE 9213604	U1	25-03-1993	KEINE		

US 2002071931	A1	13-06-2002	US	6457961 B1	01-10-2002

NL 1028415	C2	03-04-2006	KEINE		

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82